



## 114 年度工研院電子與光電系統研究所 系統晶片相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。

二、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 15 案 25 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。「讓與標的」共分為：

（一）晶片電路設計：8 案 12 件；

（二）記憶體設計：4 案 7 件；

（三）系統軟韌體：3 案 6 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）114 年 6 月 20 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 6 月 19 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「114 年度工研院電子與光電系統研究所系統晶片相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 6 月 19 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 114 年 7 月 7 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫



清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件(如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「114 年度工研院電子與光電系統研究所系統晶片相關研發成果讓與案投標」，於截標日 114 年 7 月 7 日 17 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 林小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施運用情境及金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介(20%)
2. 公司財務狀況(20%)
3. 公司營運／研發能力(20%)
4. 「讓與標的」運用規劃(30%)
5. 國內產業效益(10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。



六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方式：

- (一) 分為初審（114 年 7 月 15 日）及複審（114 年 7 月 23 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書等進行形式審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明

及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(三)點敘明外，並應於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上超過及格分之投標廠商之投標金額均超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 開標時將請律師到場監標。
- (八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- (九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
- (十) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

#### 九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- (二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經逕洽審議委員會審查通過，方得簽約。
- (三) 得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經逕洽審議委員會審查通過，方得簽約。
- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係

條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定)。前述法令變動時，亦同。

- (五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」生效前：
  - 1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
  - 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
  - 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

(十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依相關專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

(十一) 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

1. 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
2. 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
3. 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
4. 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

(十二) 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

1. 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
2. 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
3. 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

(十三) 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將

相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。

- （十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
- （十五）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
- （十六）得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後30日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。
- （十七）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商



之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 林小姐。

電話：(03) 591-6272，傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：[yijielin@itri.org.tw](mailto:yijielin@itri.org.tw)。

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。



## 附件一：本案件標的簡介

(歡迎產業界針對有興趣之標的報名公開說明會了解相關資訊。)



工業技術研究院  
Industrial Technology  
Research Institute

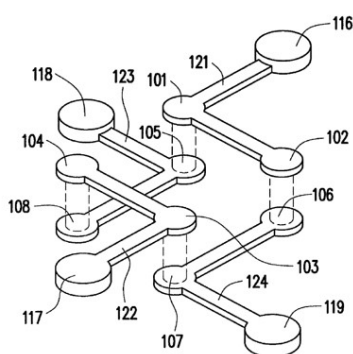
### 系統晶片技術-晶片電路設計

ELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC  
SYSTEM RESEARCH LABORATORIES

電子與光電系統研究所

#### HARDWIRED SWITCH OF DIE STACK AND OPERATING METHOD OF HARDWIRED SWITCH

##### 晶片堆疊的硬線式切換器 及硬線式切換器的操作方法



TWI387085  
US8217521  
US8912015



##### 技術特色

透過過濾和編碼輸入訊號，由記憶體控制單元與記憶體互動，同時利用啟動檢查單元監控系統以確保記憶體的運作安全。

- 提升資料可靠性
- 增強系統安全性
- 更有效的記憶體管理
- 提高系統穩定性



##### 產業應用

三維晶片堆疊之應用領域，晶圓廠、封裝廠、IC設計公司



工業技術研究院  
Industrial Technology  
Research Institute

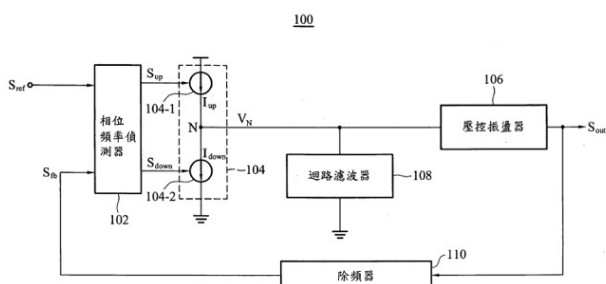
### 系統晶片技術-技術推廣

ELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC  
SYSTEM RESEARCH LABORATORIES

電子與光電系統研究所

#### Frequency synthesizer

##### 頻率合成器及校正裝置



TWI358205



##### 技術特色

一種分數式頻率合成器，透過第二信號來調整頻率合成器的電流源，以提升性能。

- 低相位雜訊
- 高輸出頻譜純度



##### 產業應用

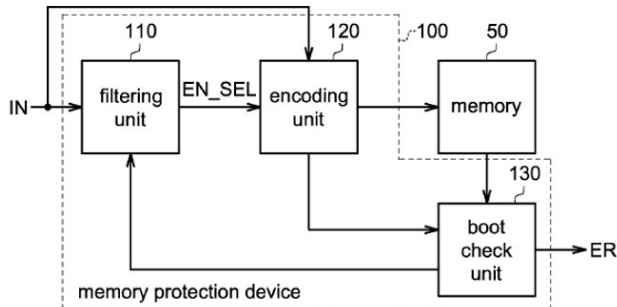
IC設計、半導體相關廠商，聯詠、智原、凌陽



## 系統晶片技術-記憶體設計

### MEMORY PROTECTION DEVICE AND METHOD

#### 記憶體保護裝置與方法



DE102015226073  
TWI569279  
US10268547



#### 技術特色

透過過濾和編碼輸入訊號，由記憶體控制單元與記憶體互動，同時利用啟動檢查單元監控系統以確保記憶體的運作安全。

- 提升資料可靠性
- 增強系統安全性
- 更有效的記憶體管理
- 提高系統穩定性



#### 產業應用

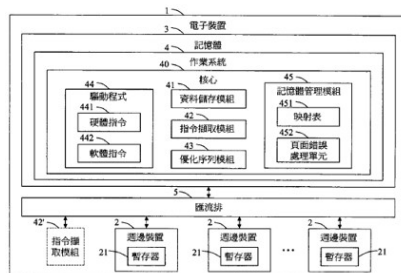
車用電子，renesas、TI、freescale、NXP、  
Bosch、盛群半導體股份有限公司、新唐科技



## 系統晶片技術-系統軟體

### METHOD FOR INITIALIZING PERIPHERAL DEVICES AND ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME

#### 初始化週邊裝置之方法 與使用此方法之電子裝置



CN106873954  
JP6194391  
TWI564802



#### 技術特色

透過記錄和重播週邊裝置的硬體暫存器設定，來簡化和加速電子裝置在休眠和喚醒後的初始化過程。

- 更快速的啟動過程
- 更有效率的資源分配
- 簡化的系統設計
- 週邊裝置的彈性支援



#### 產業應用

車機、智慧電視及其他需快速開機之智慧裝置  
產品開發商如 TSMC、MSI、Freescale



## 附件二：專利清單

### (一) 晶片電路設計：8 案 12 件

| 案次 | 件次 | 件編號         | 專利名稱                    | 國家   | 狀態 | 公告號         | 專利起期     | 專利迄期     | 委辦單位     | 專利權人 | 契約運用   |
|----|----|-------------|-------------------------|------|----|-------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 1  | 1  | P52000165CN | 能量回收裝置                  | 中國大陸 | 獲證 | CN103219867 | 20151104 | 20320321 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
|    | 2  | P52000165TW | 能量回收裝置                  | 中華民國 | 獲證 | TWI466407   | 20141221 | 20320119 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 2  | 3  | P52030045TW | 有限脈衝響應濾波器與濾波方法          | 中華民國 | 獲證 | TWI566523   | 20170111 | 20341029 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 3  | 4  | P52970105CN | 可重組態處理裝置及其系統            | 中國大陸 | 獲證 | CN102043755 | 20121205 | 20291021 | 經濟部產業技術司 | 工研院  | 曾非專屬授權 |
|    | 5  | P52970105TW | 可重組態處理裝置及其系統            | 中華民國 | 獲證 | TWI414994   | 20131111 | 20290923 | 經濟部產業技術司 | 工研院  | 曾非專屬授權 |
| 4  | 6  | P52990011TW | 半導體裝置之堆疊製程的靜電放電保護方案     | 中華民國 | 獲證 | TWI413236   | 20131021 | 20300610 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 5  | 7  | P62950038CN | 面心立方結構電容及其制造方法          | 中國大陸 | 獲證 | CN101221949 | 20110525 | 20270109 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 6  | 8  | P62960042TW | 頻率合成器及校正裝置              | 中華民國 | 獲證 | TWI358205   | 20120211 | 20280706 | 經濟部產業技術司 | 工研院  | 曾非專屬授權 |
| 7  | 9  | P62970035CN | 功率放大器及其調制器              | 中國大陸 | 獲證 | CN101753109 | 20120104 | 20281204 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 8  | 10 | P62980012TW | 晶片堆疊的硬線式切換器及硬線式切換器的操作方法 | 中華民國 | 獲證 | TWI387085   | 20130221 | 20290511 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
|    | 11 | P62980012US | 晶片堆疊的硬線式切換器及            | 美國   | 獲證 | US8217521   | 20120710 | 20301118 | 經濟部產業技術司 | 工研院  | 曾非專屬授權 |



| 案次 | 件次 | 件編號           | 專利名稱                    | 國家 | 狀態 | 公告號       | 專利起期     | 專利迄期     | 委辦單位     | 專利權人 | 契約運用 |
|----|----|---------------|-------------------------|----|----|-----------|----------|----------|----------|------|------|
|    |    |               | 硬線式切換器的操作方法             |    |    |           |          |          |          |      |      |
|    | 12 | P62980012USD1 | 晶片堆疊的硬線式切換器及硬線式切換器的操作方法 | 美國 | 獲證 | US8912015 | 20141216 | 20300813 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |      |

## (二) 記憶體設計：4 案 7 件

| 案次 | 件次 | 件編號         | 專利名稱                 | 國家   | 狀態 | 公告號            | 專利起期     | 專利迄期     | 委辦單位     | 專利權人 | 契約運用   |
|----|----|-------------|----------------------|------|----|----------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 9  | 1  | P52000018TW | 在三維晶片堆疊後可修補記憶體的技術    | 中華民國 | 獲證 | TWI482165      | 20150421 | 20310912 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
|    | 2  | P52000018US | 在三維晶片堆疊後可修補記憶體的技術    | 美國   | 獲證 | US8854853      | 20141007 | 20321120 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 10 | 3  | P52020001TW | 混合式錯誤修復方法及其記憶體裝置     | 中華民國 | 獲證 | TWI502601      | 20151001 | 20330423 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 11 | 4  | P52040059DE | 記憶體保護裝置與方法           | 德國   | 獲證 | DE102015226073 | 20170302 | 20351217 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
|    | 5  | P52040059TW | 記憶體保護裝置與方法           | 中華民國 | 獲證 | TWI569279      | 20170201 | 20351014 | 經濟部產業技術司 | 工研院  | 曾非專屬授權 |
|    | 6  | P52040059US | 記憶體保護裝置與方法           | 美國   | 獲證 | US10268547     | 20190423 | 20360607 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |
| 12 | 7  | P52050041TW | 資料存取系統、資料存取裝置及資料存取方法 | 中華民國 | 獲證 | TWI596541      | 20170821 | 20361129 | 經濟部產業技術司 | 工研院  |        |



### (三) 系統軟體：3 案 6 件

| 案次 | 件次 | 件編號           | 專利名稱                                                 | 國家       | 狀態 | 公告號         | 專利起期     | 專利迄期     | 委辦單位         | 專利權人 | 契約運用 |
|----|----|---------------|------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----------|----------|--------------|------|------|
| 13 | 1  | P52040082TWC1 | 圖案化使用者<br>介面之執行程<br>序的執行方<br>法、追蹤方法與<br>應用其之電子<br>裝置 | 中華<br>民國 | 獲證 | TWI574200   | 20170311 | 20360120 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |
| 14 | 2  | P52040102CN   | 初始化週邊裝<br>置的方法與使<br>用此方法的電<br>子裝置                    | 中國<br>大陸 | 獲證 | CN106873954 | 20200320 | 20351224 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |
|    | 3  | P52040102JP   | 初始化週邊裝<br>置之方法與使<br>用此方法之電<br>子裝置                    | 日本       | 獲證 | JP6194391   | 20170818 | 20360526 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |
|    | 4  | P52040102TW   | 初始化週邊裝<br>置之方法與使<br>用此方法之電<br>子裝置                    | 中華<br>民國 | 獲證 | TWI564802   | 20170101 | 20351213 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |
| 15 | 5  | P52050040CN   | 操控記錄方法<br>及自動執行操<br>控方法                              | 中國<br>大陸 | 獲證 | CN107632851 | 20210202 | 20361221 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |
|    | 6  | P52050040TW   | 操控記錄方法<br>及自動執行操<br>控方法                              | 中華<br>民國 | 獲證 | TWI605378   | 20171111 | 20361208 | 經濟部產<br>業技術司 | 工研院  |      |

【備註】本案件公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。